

DISCO CORPORATION

第64期

中間事業報告書

平成14年4月1日～平成14年9月30日

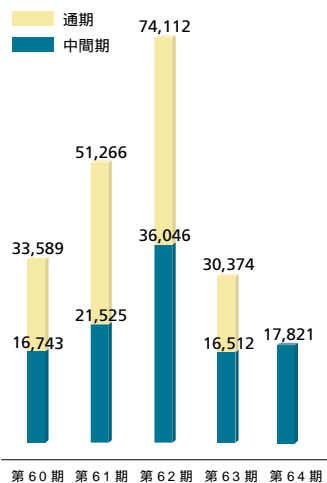


主要財務数値(中間期)

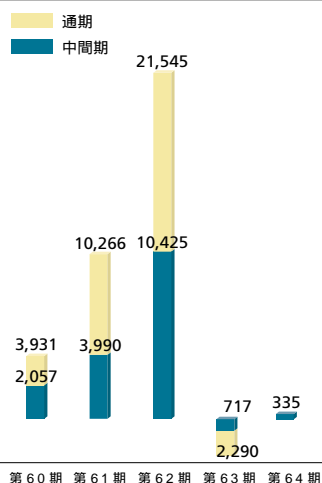
(連結)

	平成11年3月期 60期中間期	平成12年3月期 61期中間期	平成13年3月期 62期中間期	平成14年3月期 63期中間期	平成15年3月期 64期中間期
売上高(百万円)	16,743	21,525	36,046	16,512	17,821
経常利益(百万円)	2,057	3,990	10,425	717	335
中間純利益(百万円)	962	1,192	5,752	625	135
1株当たり中間純利益(円)	45.86	56.77	179.12	19.48	4.21
株主資本(百万円)	26,128	27,999	45,546	50,230	48,802
総資産(百万円)	42,338	49,232	75,439	66,085	62,189
株主資本中間純利益率(%)	3.7	4.3	13.3	1.2	0.3

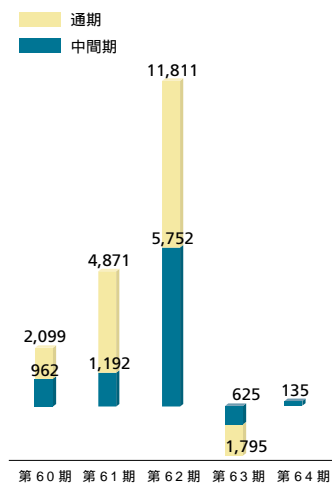
[売上高(百万円)]



[経常利益(百万円)]



[当期純利益(百万円)]



株主の皆様へ

厳しい経営環境のなか売上高、利益ともに改善

当中間期の世界経済は、一時米国、アジア諸国において経済の成長が見られましたが、米国経済における会計不信に端を発した世界同時株安や景気の減速傾向、長期化する日本のデフレや金融システムなどにより、期の後半からは景気の先行き不透明感が増した状況で推移しました。

こうした状況のもとで、当社は積極的な営業活動を展開した結果、精密ダイヤモンド砥石や機械装置の受注が回復したことを主因として、当中間期の連結売上高は178億21百万円(前年同期比7.9%増)となりました。売上面での回復に加え、製品構成の改善や前期より実施している各種コスト削減効果が浸透したことなどにより、連結営業利益は4億85百万円(前年同期比11億93百万円増)、連結経常利益は3億35百万円(同10億53百万円増)、連結中間純利益は1億35百万円(同7億60百万円増)と利益面でも黒字転換を果たしました。

技術革新に対応して技術的優位性を確保

半導体業界、電子部品業界におきましては、IT化、ブロードバンド化の進展を睨んで部品の高速・大容量化、低消費電力化、微細化などの技術革新は着実に進んでいくものと予想されます。こうした流れを受け、パッケージ形態の多様化やLow-k膜など新材料の出現、ひとつのパッケージの中に複数のチップを積層して搭載するMCP(マルチ・チップ・パッケージ)の増加など、加工法が従来以上に多様化し、かつ難しいものが増えてきており、この傾向は今後より一層顕著になっていくものと予想されます。

こうした動きは、当社にとって大きなビジネスチャンスとなりますが、こうした高度なユーザーニーズをいち早く察知して、高品質な製品をタイムリーかつ競争力のある価格で市場に投入することが、当社の技術的な優位性を維持し今後の成長を大きく左右するものと考えております。

当社としましても、引き続き積極的に研究開発を推進していくと共に、新たなマーケットの開拓に努めてまいります。



配当について

世界経済の減速懸念などから半導体業界、電子部品業界を巡る環境はこのところ不透明感が強まっており、当社ユーザーにおきましても設備投資の先送りなどの動きが一部で見られております。一方で、最先端加工に使用される装置に対する受注や引き合いは順調に推移しているなど、業績に関してはプラス面マイナス面相半ばする状況となっています。以上を踏まえ、中間配当金につきましては、一株につき10円(前中間期10円)とさせていただきます。

なお、本年10月、前期に実施した擬似ストックオプション同様、役員や従業員の業績向上努力と成果配分を株主利益により密接に関連付けることにより、業績向上と株主重視の経営を一段と進める狙いから、当社及び子会社の役員、従業員の一部を対象にストックオプションを発行いたしました。引き続き企業価値向上のため努力してまいります。

株主の皆様におかれましては、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 溝呂木 育

ハイテク製品におけるディスコの役割

今日の私たちの身近にあるパソコンや携帯電話はもとより、PDA（携帯情報端末）や家庭用ゲーム機、デジタルカメラ、音響・映像製品、家電製品、自動車などにいたるまで、様々なエレクトロニクス関連製品にはそれを制御したりデータを記憶するため心臓部に半導体が用いられています。

半導体メーカーは、日本国内をはじめ、北米、アジア、ヨーロッパなどの世界各地にあり、いずれもグローバルなビジネスを展開しております。国内半導体メーカーではその多くに大手総合電機メーカーが挙げられます。これらの半導体メーカーに製造装置を供給しているのが、われわれ半導体製造装置メーカーと呼ばれる企業です。

近年では半導体製造装置メーカーが半導体メーカーと共に積極的に共同開発や技術提携を行うなど、半導体製造プロセス等の

技術革新においてきわめて重要な役割を担っております。私たちの身近な快適さを支えている半導体。今やその製造や技術革新には半導体製造装置メーカーの存在は必要不可欠であり、ITやエレクトロニクス分野での一基幹産業と位置づけられています。

半導体の製造プロセスは大きく分けて、前工程と後工程に大別されます。この2つはそれぞれ多数の工程に細分化されており、各々の工程には専用の製造装置が使用されています。このプロセスの中でディスコは自社の得意領域である精密に「切る、削る、磨く」技術力をコアとしてダイシング工程、グラインディング工程を中心に事業展開をしています。

ダイシングは後工程の1番最初の工程で、回路を焼き付けたシリコンウェハからICチップを1つずつ賣の目(ダイス)に切り分ける工程です。ハイテク産業と呼ばれる半導体産業ではこの回路の

ハイテク製品と半導体

半導体製造プロセス（後行程）



極小化・極薄化が驚異的なスピードで進んでいるためマイクロレベルでの精密な切断技術が求められます。この精密切断を行う切断装置がディスコの主力製品であるダイシングソーです。この装置にダイヤモンドブレードという刃を装着し高速回転させてウェーハを切断します。ダイヤモンドブレードとはディスコの起源である工業用砥石の専門メーカーとしての独自の技術やノウハウが基礎となっている切断砥石のことで、ディスコではお客様の多種多様な加工ニーズに合わせて数千もの種類を擁しております。ディスコはダイシングソーやダイヤモンドブレードでは圧倒的な市場シェアを有しており、私たちの身の回りにあるほとんどの電化製品に入っている半導体の切断加工にディスコ製品が関わっているといっても過言ではありません。

ディスコが高い市場シェアを保っているのは、生産活動に必要

な装置と砥石の両方を製造している世界で唯一のメーカーであり、さらに、この両者を上手くマッチングさせ最適な加工条件をご提案できる技術(アプリケーション技術)を有しているからです。これによってディスコは強い競争力を持ち続けているのです。本社のアプリケーションラボでは、計25台の装置と約2,000種類もの砥石を常時揃え、来社、預かりを含め年間1,200件以上のテストカット依頼にお応えしております。この結果、多種多様なお客様ニーズにマッチした最適なソリューションを提供できるのです。

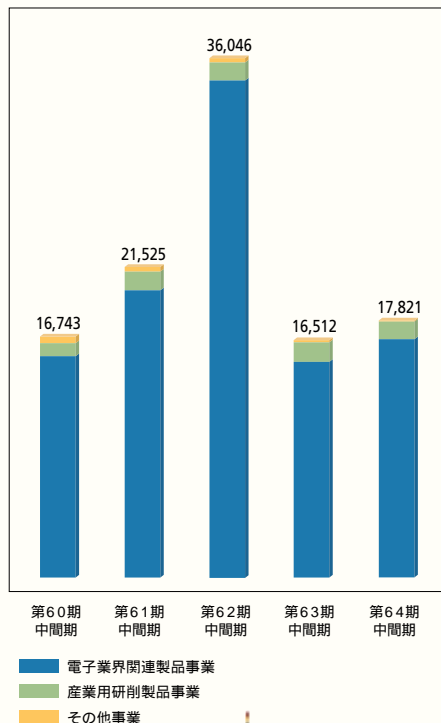
私たちディスコはソリューションプロバイダーとしての誇りを持ち、グローバル化と技術革新を推し進め、競争優位性の創出と社会生活の快適さを追求しつづけます。

半導体が利用されている最終製品



部門別営業概況

[部門別売上高推移 (百万円)]



グラインダー

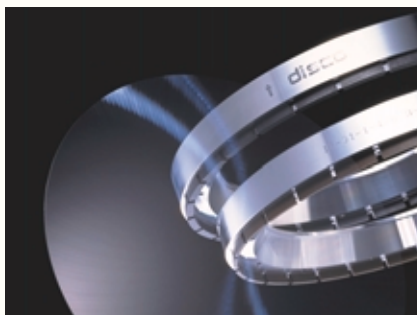
当社の事業の種類別セグメントは、(1)精密電子部品などを加工する装置、砥石、その周辺サービス、また加工した部品などを製造・販売している電子業界関連製品事業、(2)コンクリート、アスファルト、石材等を加工するダイヤモンドホイールなどを製造・販売している産業用研削製品事業、(3)コンピュータシステムのソフトウェアの開発・販売をしているその他事業の3つに分けられます。このうち電子業界関連製品事業が売上高規模で90%以上を占めており、主たる収益源となっています。

(1)電子業界関連製品事業

半導体メーカーや電子部品メーカーは、パソコンや携帯電話、デジタル家電などの最終製品の在庫調整の終了を受け、前年度と比較して生産拡大や設備投資の再開を始めています。

当連結中間期におきましては、半導体メーカーの生産稼働率が引き続き改善したことを受け、消耗品である精密ダイヤモンド砥石の受注が期初より好調であったことに加え、ダイシングソー、グラインダーなどの装置の受注が大幅に改善した結果、部門売上高は前年同期比10.4%増の165億14百万円となりました。

地域別では、半導体メーカーの製造拠点のアジア地域への移転などにより北米地域が減少した反面、台湾、シンガポール、マレーシア、タイなどのアジア地域やヨーロッパ地域は半導体メーカーの設備投資の再開や回復を受け、売上増を達成しました。



精密ダイヤモンド砥石
(グライディングホイール)



産業ダイヤモンド砥石

半導体および電子部品業界からは従来の製品や技術へのニーズのみならず、技術革新に対応した製品や技術へのニーズも拡大しつつあります。

当社は、今後の市場動向や技術動向を見据えながら、当社独自の技術力により、積極的に事業展開を図ってまいります。

(2) 産業用研削製品事業

当部門は、アスファルト、コンクリート、石材などを加工するダイヤモンドホイール、研削切断砥石など、主として建築・土木業界向けの研削切断工具の製造・販売を行っています。当中間期は積極的な販売活動を展開しましたが、国や地方公共団体による公共事業抑制策などの影響を受け、売上高は12億88百万円と前年同期比8.0%の減少となりました。なお当事業はより一層の利益責任を持たせ経営効率を図るべく昨年度下期に㈱ディスコ アブレイシブ システムズとして分社化しております。

(3) その他事業

当部門は、半導体製造装置向けなどのコンピュータシステムのソフトウェアの開発・販売を主としています。当中間期は前中間期のような大口受注が入らず、部門売上高は前年同期比55.8%減の96百万円となりました。

財務諸表(連結)

連結貸借対照表

科 目	(単位:百万円)	
	63期通期 (平成14年3月31日現在)	64期中間期 (平成14年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	7,762	6,127
受取手形及び売掛金	8,526	10,544
棚卸資産	18,561	17,030
その他	2,275	2,316
流動資産合計	37,126	36,018
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,863	8,514
機械装置及び運搬具	3,096	2,966
土地	5,720	5,716
その他	1,857	2,086
有形固定資産合計	19,538	19,283
無形固定資産	953	871
投資その他の資産		
投資有価証券	1,345	1,354
その他	4,755	4,662
投資その他の資産合計	6,101	6,016
固定資産合計	26,593	26,171
資産合計	63,720	62,189

連結損益計算書

科 目	(単位:百万円)	
	63期中間期 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	64期中間期 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)
売上高	16,512	17,821
売上原価	9,282	9,799
売上総利益	7,229	8,021
販売費及び一般管理費	7,938	7,536
営業利益	708	485
営業外収益	181	172
営業外費用	190	322
経常利益	717	335
特別利益	32	34
特別損失	172	28
税金等調整前中間純利益	857	341
法人税、住民税及び事業税	134	232
過年度法人税等戻入額	534	
法人税等調整額	169	15
少数株主損失	2	10
中間純利益	625	135

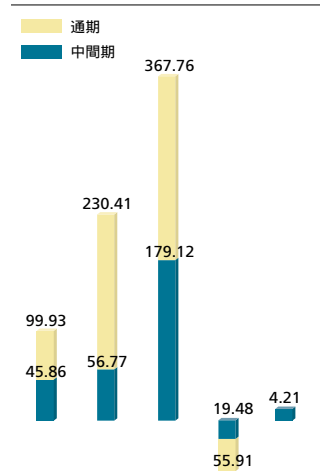
科 目	(単位:百万円)	
	63期通期 (平成14年3月31日現在)	64期中間期 (平成14年9月30日現在)
(負債の部)		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,077	3,353
短期借入金	5,473	2,912
未払法人税等	675	647
その他	2,740	2,955
流動負債合計	10,967	9,869
固定負債		
新株引受権付社債	312	312
長期借入金	733	699
退職給付引当金	1,529	1,593
その他	919	868
固定負債合計	3,494	3,474
負債合計	14,462	13,343
(少数株主持分)		
少数株主持分	54	43
(資本の部)		
資本金	9,770	
資本準備金	10,637	
連結剰余金	28,794	
その他有価証券評価差額金	57	
為替換算調整勘定	51	
自己株式	4	
資本金	9,770	
資本剰余金	10,637	
利益剰余金	28,604	
その他有価証券評価差額金	42	
為替換算調整勘定	246	
自己株式	6	
資本合計	49,203	48,802
負債、少数株主持分及び資本合計	63,720	62,189

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

科 目	(単位:百万円)	
	63期中間期 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	64期中間期 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,718	1,881
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,818	508
財務活動によるキャッシュ・フロー	150	2,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	91
現金及び現金同等物の増加額	12,369	1,635
現金及び現金同等物の期首残高	18,891	7,762
現金及び現金同等物の中間期末残高	6,522	6,127

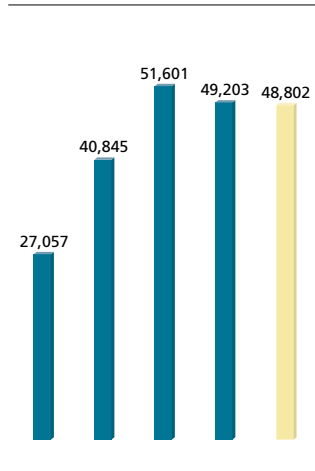
業績の推移(連結)

【一株当たり中間(当期)純利益(円)】



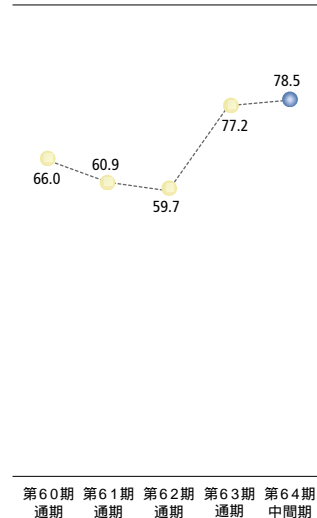
第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

【株主資本(百万円)】

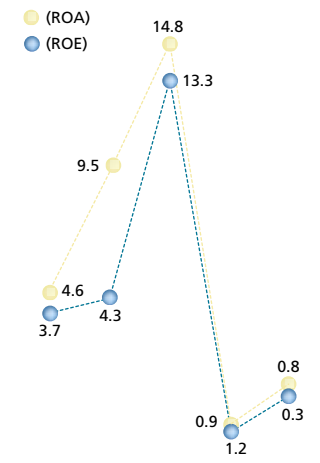


第60期 第61期 第62期 第63期 第64期
通期 通期 通期 通期 中間期

【株主資本比率(%)】

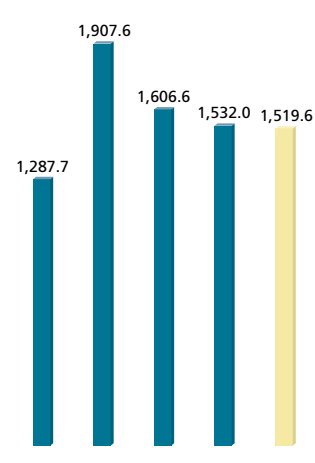


【総資産事業利益率(ROA) / 株主資本当期利益率(ROE)(%)】



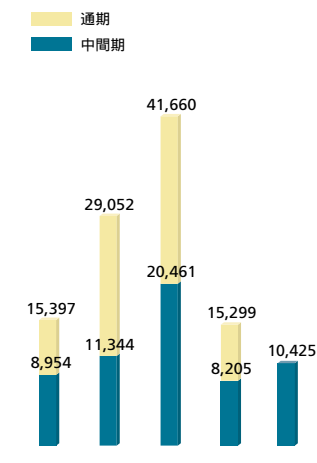
第60期 第61期 第62期 第63期 第64期
中間期 中間期 中間期 中間期 中間期

【一株当たり株主資本(円)】



第60期 第61期 第62期 第63期 第64期
通期 通期 通期 通期 中間期

【海外売上高(百万円)】



第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

(注)事業利益 = 営業利益 + 受取配当金 + 受取利息

財務諸表(単独)

貸借対照表

科 目	(単位:百万円)	
	63期通期 (平成14年3月31日現在)	64期中間期 (平成14年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	4,442	3,694
受取手形	462	656
売掛金	4,992	6,513
棚卸資産	15,479	14,292
その他	5,427	4,754
流動資産合計	30,805	29,911
固定資産		
有形固定資産		
建物	7,124	6,842
土地	4,983	4,983
その他	4,721	4,832
有形固定資産合計	16,829	16,658
無形固定資産		
投資その他の資産	687	609
投資その他の資産		
投資有価証券	861	832
関係会社株式	2,835	2,850
その他	4,148	3,904
投資その他の資産合計	7,845	7,588
固定資産合計	25,362	24,856
資産合計	56,168	54,767

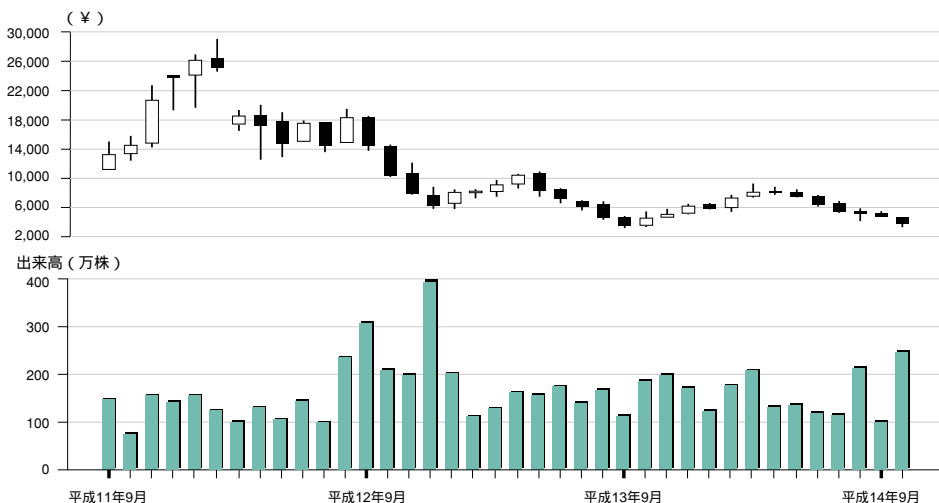
損益計算書

科 目	(単位:百万円)	
	63期中間期 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	64期中間期 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)
売上高	11,331	11,846
売上原価	6,446	6,476
売上総利益	4,885	5,370
販売費及び一般管理費	6,258	5,486
営業利益	1,373	115
営業外収益	2,041	445
営業外費用	122	171
経常利益	545	157
特別利益	3	0
特別損失	162	14
税引前中間純利益	386	143
法人税、住民税及び事業税	9	27
過年度法人税等戻入額	534	
法人税等調整額	198	60
中間純利益	713	56
前期繰越利益	9,721	9,000
中間未処分利益	10,434	9,057

科 目	(単位:百万円)	
	63期通期 (平成14年3月31日現在)	64期中間期 (平成14年9月30日現在)
(負債の部)		
流動負債		
支払手形	837	1,242
買掛金	528	1,264
短期借入金	3,000	400
未払法人税等	39	9
その他	1,843	2,223
流動負債合計	6,249	5,138
固定負債		
新株引受権付社債	312	312
退職給付引当金	1,353	1,401
その他	844	788
固定負債合計	2,510	2,501
負債合計	8,759	7,640
(資本の部)		
資本金		
法定準備金	9,770	
11,231		
剰余金	26,353	
その他有価証券評価差額金	57	
自己株式	4	
資本金	9,770	
資本剰余金		
10,637		
利益剰余金	26,683	
その他有価証券評価差額金	42	
自己株式	6	
資本合計	47,408	47,127
負債及び資本合計	56,168	54,767

株式の状況

株価チャート



Visit Us!

ホームページアドレス
<http://www.disco.co.jp/>

株 主 メ

決算期
 定時株主総会
 利益配当金受領株主確定日
 中間配当金受領株主確定日
 名義書換代理人

同 事 務 取 扱 所

同 取 次 所
 公 告 掲 載 新 聞

モ

毎年3月31日
 毎年6月
 毎年3月31日
 毎年9月30日
 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号
 UFJ信託銀行株式会社
 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
 UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
 TEL(03)5683-5111 (代表)
 UFJ信託銀行 全国各支店
 日本経済新聞





DISCO CORPORATION